

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 3118—88

晶 片 承 载 器

1988—04—08 发布

1988—12—01 实施

中华人民共和国电子工业部 发布

晶片承载器

1 主题内容与适用范围

本标准规定了晶片包装盒、传递片架和清洗片架的晶片承载器的品种、规格、尺寸和技术要求。

本标准适用于半导体材料、分立器件和集成电路生产过程中晶片的包装、传递和清洗用的晶片承载器。

2 晶片承载器术语

2.1 晶片包装盒：用于半导体材料、分立器件和集成电路生产过程中晶片的包装、储存和运输，具有防止晶片破损和污染作用的一种晶片承载器。

2.2 晶片传递片架：用于半导体材料、分立器件和集成电路生产过程中，对晶片进行自动化加工和测试的一种晶片承载器。

2.3 晶片清洗片架：用于半导体材料、分立器件和集成电路生产过程中，对晶片进行清洗的一种晶片承载器。

3 晶片承载器的牌号

3.1 晶片承载器的牌号由下列几部分组成

J B、C、Q、C、 ×× P、M

晶片种类
数字代表晶片直径
承载器代号
承载器类别代号
晶片代号

J——晶片
C——承载器
B——包装盒
C——传递片架

Q——清洗片架
××数字——晶片直径
(P)——抛光晶片
(M)——切磨晶片

3.2 晶片承载器牌号示例

3.2.1 JBC—75(P) 表示直径 75mm 抛光晶片包装盒承载器。

3.2.2 JBC—75(M) 表示直径 75mm 切磨晶片包装盒承载器。

3.2.3 JCC—75 表示直径 75mm 晶片传递片架承载器。

3.2.4 JQC—75 表示直径 75mm 晶片清洗片架承载器。

4 晶片包装盒承载器

4.1 晶片包装盒承载器示意图 1 和图 2。

4.2 晶片包装盒承载器品种、规格、尺寸和标记应符合表 1 规定。

4.3 磨片(晶片)包装盒承载器、无片槽、故无 n 、 L_2 和 b_{15} 、 b_{16} 、 h_6 等尺寸。